

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】令和 7 年 5 月 21 日(2025.5.21)

【国際公開番号】WO2023/136253

【出願番号】特願 2023-574042(P2023-574042)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/14(2006.01)

H 0 5 K 1/03(2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/14 R

H 0 5 K 1/03 6 1 0 H

10

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 5 月 13 日(2025.5.13)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 1 7 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【0 1 7 9】

< 界面ボイドの評価 >

( 1 ) 樹脂シートの積層

実施例及び比較例で作製した樹脂シートを、シート貼り付け装置を用いて、樹脂組成物層が基材と接合するように、基材の片面に積層した。比較例 1 においては、樹脂組成物層と基材とを接合させた後、処理対象の樹脂シートと基材が格納されるチャンバ内を減圧して雰囲気圧力を 13 hPa 以下とした。他方、実施例 1 ~ 8 及び比較例 2 においては、処理対象の樹脂シートと基材が格納されるチャンバ内を減圧して雰囲気圧力を 13 hPa 以下とした後に、樹脂組成物層と基材とを接合させた。そして温度 100 、圧着圧力 0.5 MPa にて 100 秒間圧着することにより樹脂シートを基材に積層した。

30

40

50